

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

### 胜宏科技(惠州)股份有限公司投资者关系活动记录表

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	广发证券、招商证券、国泰基金、华商基金、博时基金、华夏基金、睿远基金、中欧基金、汇添富基金、财通基金、景顺长城、东方资管、泉果基金、兴证全球基金、嘉实基金、安信基金、富国基金、新华资产、景林基金、望正资产、淡水泉、红土创新基金、聚鸣投资、融通基金、诺德基金、银河证券、长城基金、信达澳亚、西部证券、兴业证券、国投瑞银基金、嘉合基金、三希（北京）资管、国华兴益保险、浙江泮博资管、长宜（北京）私募基金、北京海绵私募基金、杭州天泉证道私募基金、上海十溢投资、誉辉资本管理、陆家嘴国泰人寿保险、北京诚旻投资、上海山楂树私募基金、上海君牛私募基金、锐方（上海）私募基金、上海茂硕资管、泰信基金、上海格传私募基金等144位机构投资者。
<b>时间</b>	2026年03月06日
<b>地点</b>	上海、深圳
<b>上市公司接待人员姓名</b>	1、董事会秘书、副总裁：朱溪瑶 2、投资者关系经理：王慧珍
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<b>一、介绍公司基本情况</b>  2025 年度，公司坚定“拥抱 AI，奔向未来”，精准把握 AI 算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，持续巩固在全球 PCB 制造领域的技术领先地位。随着全球 AI 基础设施与算力需求的持续扩张，公司

凭借行业领先的技术能力、品质能力、交付能力和全球化服务能力，成为国内外众多头部科技企业的核心合作伙伴。在 AI 算力、数据中心、高性能计算等关键领域，多款高端产品已实现大规模量产，带动产品结构向高价值量、高技术复杂度方向升级，高端产品占比显著提升，推动公司业绩高速增长。

## 二、互动交流环节具体情况如下：

### 1、公司未来的扩产计划如何？产能爬坡节奏是怎样的？

答：为巩固公司在全球 PCB 行业的领先地位，强化在 AI 算力、AI 服务器等领域的优势，提升全球化交付服务能力，公司持续扩充高阶 HDI、高多层 PCB 及 FPC 等产品产能，包括惠州、泰国、越南及马来西亚工厂扩产项目等，扩产速度行业领先。

公司的扩产节奏正在加速推进，在基建、装修、设备配置及人才储备等多方面提前进行规划准备。新建厂房需经历厂房建设装修、设备安装调试、客户审厂、送样测试、订单下达及量增等阶段，初期的产线磨合和产能产量逐步释放是行业的必经过程，公司对后续的生产经营及效益实现充满信心。

### 2、公司收购马来西亚SunPower的原因？

公司收购马来西亚 SunPower 是为了后续与 MFSS 现有马来西亚子公司进行整合，提升公司在东南亚的 FPC/PCB 生产能力，有利于快速满足客户的海外交付需求，打造全球化供应能力，并对公司现有的订单需求及未来的业务拓展形成强有力的驱动，进一步构建覆盖东南亚以及欧美市场的高端制造、客户服务与区域协同的运营网

络。

### 3、公司与同行在HDI等高端PCB领域的竞争优势有哪些？

目前，国内 PCB 企业在 AI 服务器等高端 PCB 领域的竞争格局相对稳定，率先实现大规模量产的企业凭借先发优势、客户认证壁垒和量产经验积累，已构筑起了较高的竞争壁垒。目前，公司拥有行业里最丰富的 AI PCB 产品大规模量产经验，并已切入多家全球顶级服务器客户供应链。

#### （1）技术优势

公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒，领先市场量产技术 2-3 年。公司在 AI 算力、AI 服务器领域技术全球领先。

#### （2）品质优势

公司产品稳定、可靠性强，高阶 HDI 及高多层良率均为行业领先水平。AI 技术在全流程各检测站分别实现全覆盖，可自动判别、自动筛选、自动统计、自动分析，确保不良品零流出。通过 AI 历史数据建档，精准分析高频问题发生环节，推动产品不良持续改善，实现零缺陷生产目标。

#### （3）产能优势

公司现有产能涵盖广东、湖南、泰国、马来西亚等多个地区，其中，惠州总部已成为全球规模最大的单体 PCB 生产基地，全球化交付、服务能力行业领先。未来，随着惠州工厂、泰国工厂、越南工厂及马来西亚工厂的扩产项

目陆续投产爬坡，公司的高端产品产能将进一步提高，能够更好地满足客户全球化交付需求。

#### (4) 客户优势

凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，与众多国内外科技巨头公司深度合作，从产品规划到技术能力提升，再到扩产计划，全程跟踪服务客户，已形成较强的技术壁垒与客户粘性，市场竞争力强劲，构建了深厚的护城河。

#### 4、CPO技术是否会全面替代背板？其技术路线有何特点？

CPO 技术不会全面替代背板，其仅在特定方案或场景使用，且造价较高，背板市场总量会进一步增长。CPO 技术路线并非往短小轻薄方向，而是沿通信板方向，是厚板、大板、高阶高层方案。

在 CPO 技术演进中，原本分散的可插拔部件更趋于集成化，部分传输功能可能集成到芯片内，PCB 在原有高电性能、稳定性、可靠性基础上增加高精密线宽线距工艺，平整度要求、加工精度要求、复杂程度会进一步提高，材料方面也有创新突破，产品 ASP 会进一步提高。

#### 5、目前公司产能建设的优先级调整情况是怎样的？

公司新建厂房的建设速度较快，且扩产所需的设备已提前预订并陆续交付中。目前公司产能建设的优先级调整为优先进行中国大陆产能的设备安装调试工作，同时越南工厂也在原基础上进一步提速；海外与国内产能建设优先级调整的原因包括客户需求变化、海外工程师资源不足导致调试速度慢等因素。

	<p><b>6、公司产品良率有进一步提高吗？</b></p> <p>公司产品稳定、可靠性强，高阶 HDI 及高多层良率均为行业领先水平。近一年来，公司产品生产良率进一步提高。</p> <p><b>7、港股目前的进展是怎样的？</b></p> <p>港股上市发行相关工作正在有序推进中，公司与中介机构紧密协作，全力以赴落实各项上市流程，力争早日登陆香港资本市场，如有下一步重大进展将及时公告披露。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年03月09日</p>